



Paris, le 12 mai 2016

Le CEA annonce une collaboration étendue avec Intel pour faire avancer la recherche et l'innovation de pointe dans les domaines clés du numérique

Le CEA et Intel renforcent leur collaboration au travers d'un nouvel accord de R&D signé à Paris le jeudi 12 mai. Cette collaboration, étendue à plusieurs domaines clés du numérique, permettra au CEA et à Intel de développer un programme de R&D commun, et de répondre conjointement aux appels à projet dans le domaine de la recherche et de l'innovation au niveau européen, particulièrement pour le calcul haute performance (HPC) dans le cadre du programme H2020.

Le nouvel accord CEA-Intel porte sur plusieurs programmes de recherche stratégiques avec les équipes de l'institut Leti du CEA à Grenoble dont l'Internet des Objets, les communications sans fil haute vitesse, les technologies de sécurité et l'affichage 3D. Cela signifie également que les deux sociétés vont travailler ensemble pour répondre en commun aux appels à projet du programme H2020, le plus grand programme de recherche et d'innovation en Europe.

Cet accord, signé pour cinq ans minimum, porte sur le co-développement de technologies numériques, notamment dans l'Internet des Objets (IoT), comme par exemple :

- La mise au point de nouveaux matériaux afin de progresser dans la miniaturisation et l'adaptabilité des composants électroniques qui équipent les téléphones mobiles. La nature de ces composants, et leur agencement, est en effet d'une importance primordiale dans la performance du téléphone, ainsi que dans sa taille et son coût.
- Le développement des systèmes de communication sans fil et l'augmentation de leur vitesse d'échanges,
- L'intégration des objets connectés et l'étude des technologies de communication de basse consommation.

Après la signature de l'accord à Paris, la Directrice de l'institut Leti du CEA, Marie-Noelle Semeria a souligné que « *le CEA et Intel disposent d'un solide historique de développement technologique commun dans le domaine du calcul haute performance. Cette collaboration marque la reconnaissance du CEA-Leti comme l'un des acteurs les plus innovants d'Europe dans le domaine de l'IoT et dans les technologies à la base du Cloud computing et des Big Data. Il renforce également l'attractivité de la vallée grenobloise autour de la microélectronique* ».

Pour le vice-président du Data Center Group et directeur général de l'Enterprise and HPC Platform Group d'Intel, Raj Hazra, « *Cette annonce étend notre relation de longue date autour du calcul haute performance avec le CEA pour conduire l'innovation de pointe dans les domaines de l'internet des objets, du sans fil et la sécurité dans la communauté européenne. Nous attendons avec impatience les importantes innovations et les découvertes à venir de cette collaboration* ».

Contacts médias

Tuline LAESER - Tel: 01.64.50.20.97 / email: tuline.laeser@cea.fr